

免責聲明

本營運成果說明對當前預期性的前瞻性陳述,存在某種程度風險及不確定性,實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果存在某種程度的差異。

除法律要求外,我們對於新資訊或未來事件不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

Contents

- 1. 公司簡介
- 2.2023年第四季經營績效
- 3. 營運展望
- 4. Q&A

劉彥志 財務長

劉彥志 財務長

李遠忠 執行長



01 公司簡介

公司概況



主要產品上下游

上游原料

Fluoropolymer Raw Material Provider











Semi-Finished Products









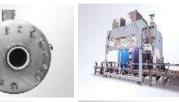


















下游客戶

Customers

IC Industry (半導體產業)

EL Chemical Industry (電子化學品產業)

> LCD Industry (面板產業)

Petrochem (化工產業)

產品別分類



氟素樹脂材料

因應半導體及各產業所需的氟素樹脂 (PTFE、M-PTFE、PFA、PFA HP、PFA HP PLUS...等)產品,上品研發並製作氟 素樹脂內襯板材與焊接材料。



氟素樹脂內襯

氟素樹脂內襯產品廣泛的應用於半導體設備、生化科技、製藥和精密化學工業等高 純度要求的桶槽、槽車和所有藥液接觸的 容器,以及客製化的熱交換器、溢流槽、 治具等。



氟素工程

因應半導體及各產業所需,上品提供流體 力學計算、高純化學品設備系統之設計規 劃、製造及安裝一套完整的服務

主要產品-氟素樹脂材料



內襯板材與素板









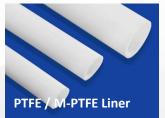
內襯直管用管材













客製化射出件











主要產品-氟素內襯設備&管件



ISO TANK Container



TEFPASS® Lining Pipe Fitting



Filter Housing



Heat Exchanger



TEFPASS[®] Column



TEFPASS® Column



Valve



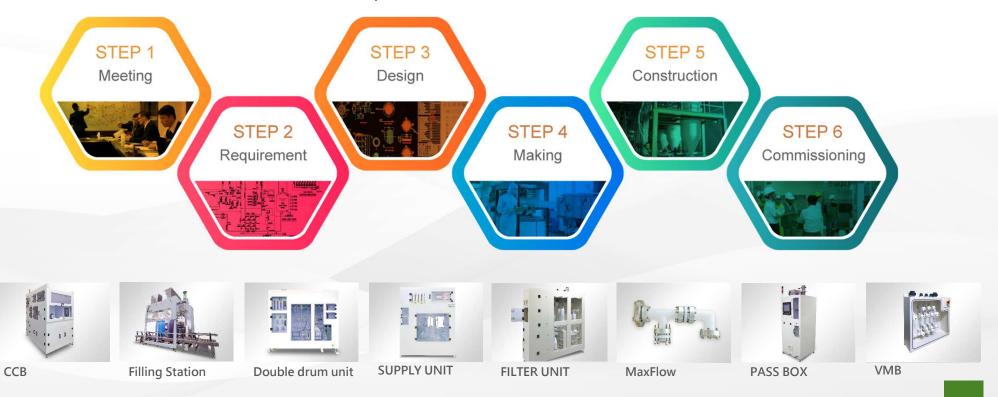
Lining Tanks/Equipment

主要產品-氟素樹脂工程



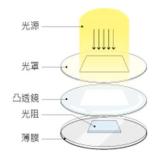
For EL Grade Chemical CCB & Filling Station

We offer total solution fluoropolymer engineering for EL grade chemical provider and semiconductor industries.



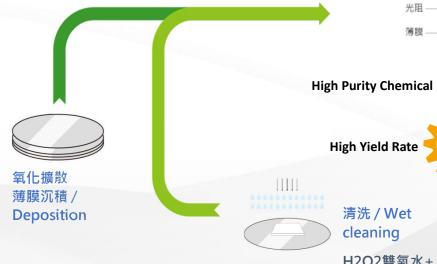
產品應用

高純電子化學品為半導體製程良率之關鍵 TEFPASS® 為高純化學品維穩之成功所在



光阻塗佈+曝光微影/ **Photolithography**

Photoresist光阻液 (PR), EBR, TMAH, Thinner光阻稀 釋液 (PGMEA, PGME)



Stable quality of IC chips

Green & circular economy

離子植入 / Ion implantation 抛光研磨 / CMP 蝕刻/去光阻/ 檢測產出

清洗/Wet cleaning

H2O2雙氧水+ NH4OH氨水 + H2O (APM)

TEFPASS®

H2O2雙氧水 + HCL鹽酸 + H2O (HPM)

H2O2雙氧水 + H2SO4硫酸 + H2O (SPM)

HF氫氟酸 + H2O (DHF)

NH4OH氨水 + HF氫氟酸+ H2O (BHF)

NH4F + HF氫氟酸(BOE/BHF)

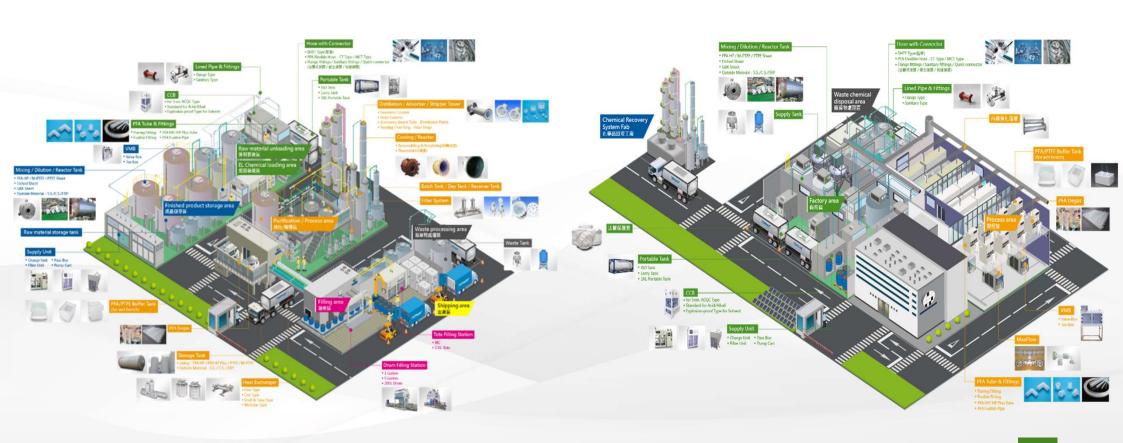
H3PO4磷酸, IPA異丙醇

Etching

HF氫氟酸, H2SO4硫酸, H3PO4磷酸, Stripper剝離液, BOE, Al- Etching, Cu-Etching, Thinner光 阻稀釋液 (PGMEA, PGME)

https://www.alliedsupreme.com/

產品應用場景-從"電子化學品製造"至"半導體晶圓廠"



競爭優勢

一站式氟素相關 應用服務廠商

原料、製造、組裝、物流 及品質檢測一手包辦 自製率達8成以上

• 氟素材料/半成品

規格多樣化

工法創新

• 氟素內襯施工

全球唯-

獨家創新



氟素樹脂加工製造

領導品牌

產品線齊全 適用多產業 上下游產品垂直整合 品質優良具成本優勢

產品觸及半導體、電子級化學 品、面板、化工及能源產業等

高純化學品 運輸平台 創新方案

化學品運輸效益、 安全性及優化減廢 節能提升

關鍵產品:高純電子級特用 化學品槽車

產品線	上品	同業	
氟原料	X	X	
氟半成品材料生產	V	X	
氟內襯設備加工	V	V	
工程服務	V	Х	

可為全球電子化學品之生產廠商及 半導體客戶之在地化提供關鍵設備

產品創新







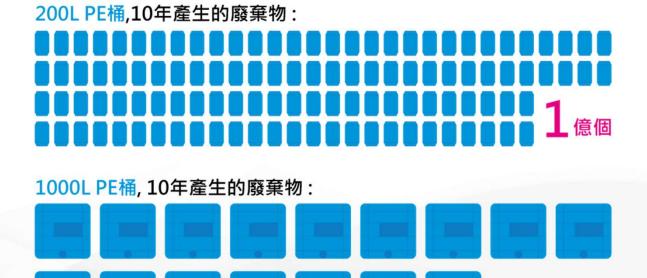
上品為減少浪費及降低塑料桶廢棄物產生 而努力

200L PE桶



1000L PE桶





TEFPASS® Sheet/GBK Lined ISO-TANK, 10年產生的廢棄物:

2000萬個

2023年獲獎殊榮

第8屆經濟部國家產業創新獎 績優創新企業



8th National Industrial Innovation Award 2023

第7屆中堅企業遴選

卓越中堅企業獎



7th Taiwan Mittelstand Award 2023





經營績效

Quarterly Consolidated Income Statement

In NT\$ thousands

(In NT\$ thousands)	會計科目	4Q23	3Q23	QoQ	4Q22	YoY
Net sales	營業收入	1,288,456	1,234,905	4%	1,630,670	-21%
Gross profit	營業毛利	635,248	573,912	11%	763,711	-17%
Operating exp.	營業費用	156,811	161,759	-3%	170,757	-8%
Operating profit	營業淨利	475,549	408,438	16%	598,652	-21%
Non-ope items	營業外收支	1,903	49,408	-96%	(1,080)	-276%
Pre-tax profit	稅前淨利	477,452	457,846	4%	597,572	-20%
Tax exp.	所得稅費用	91,519	74,384	23%	92,213	-1%
Net profit	本期淨利	385,933	383,462	1%	505,359	-24%
EPS	每股盈餘	4.84	4.82	0.02	6.38	- 1.55
Margins %	比率 %	4Q23	3Q23	QoQ	4Q22	YoY
Gross profit	毛利率	49.3%	46.5%	2.8%	46.8%	2.5%
Ope exp.	營業費用率	12.2%	13.1%	-0.9%	10.5%	1.7%
Ope profit	營業利益率	36.9%	33.1%	3.8%	36.7%	0.2%
Non-ope items	業外收支率	0.1%	4.0%	-3.9%	-0.1%	0.2%
Pre-tax profit	稅前淨利率	37.1%	37.1%	0.0%	36.6%	0.4%
Net Profit	純益率	30.0%	31.1%	-1.1%	31.0%	-1.0%

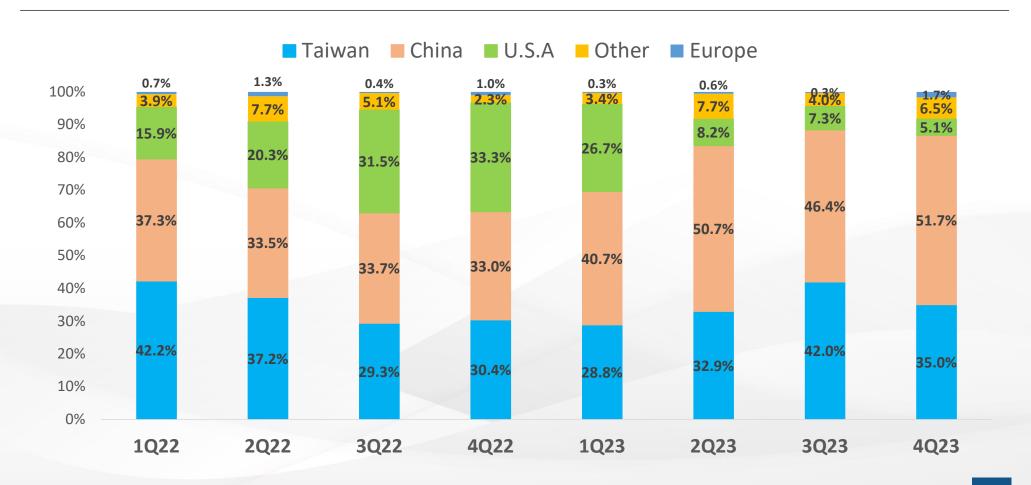
In NT\$ thousands

(In NT\$ thousands)	會計科目	2023FY	2022FY	YoY
Net sales	營業收入	5,692,353	6,138,088	-7%
Gross profit	營業毛利	2,643,996	2,765,339	-4%
Operating exp.	營業費用	628,451	638,832	-2%
Operating profit	營業淨利	2,002,947	2,132,205	-6%
Non-ope items	營業外收支	78,177	49,511	58%
Pre-tax profit	稅前淨利	2,081,124	2,181,716	-5%
Tax exp.	所得稅費用	397,871	405,699	-2%
Net profit	本期淨利	1,683,253	1,776,017	-5%
EPS	每股盈餘	21.22	22.54	- 1.32
Margins %	比率 %	2023FY	2022FY	YoY
Gross profit	毛利率	46.4%	45.1%	1.4%
Ope exp.	營業費用率	11.0%	10.4%	0.6%
Ope profit	營業利益率	35.2%	34.7%	0.4%
Non-ope items	業外收支率	1.4%	0.8%	0.6%
Pre-tax profit	稅前淨利率	36.6%	35.5%	1.0%
Net Profit	純益率	29.6%	28.9%	0.6%

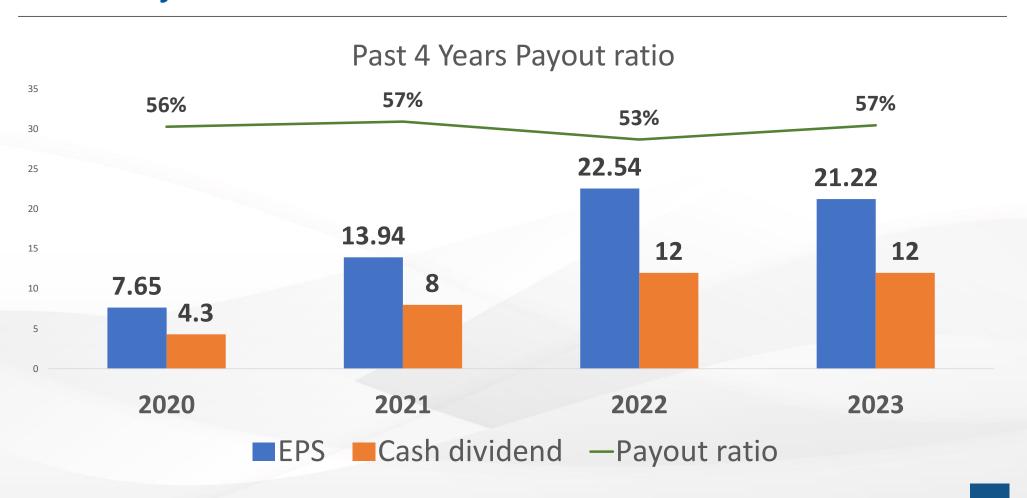
2023 Sales revenue % by Industries (產業別)



2023 Sales revenue % by Customers Location (地區別)



Stable Payout Ratio







03 營運展望

營運展望

> 大環境動能逐漸復甦

> 短期展望

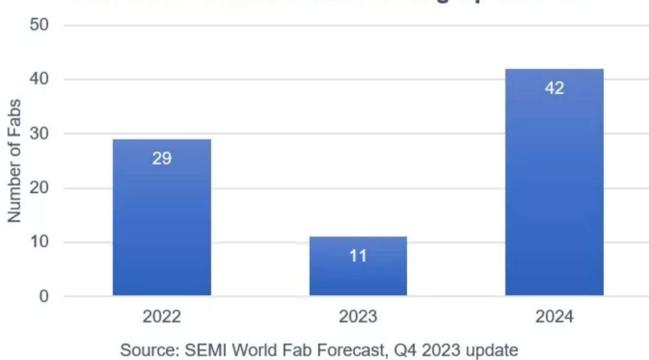
- ◆ 中國廠受到春節長假干擾,員工於解封後返鄉,工作天數減少影響。
- ◆ 上半年度出貨穩定,中國廠稼動率滿,台灣廠稼動率較去年上升,上半年度 有機會逐步回到9成。

> 中長期展望

◆ 伴隨美國、歐洲半導體發展,推展國際化布局,是未來幾年的重點發展市場, 希望切入非台系客戶之內襯設備銷售。

SEMI: 2024年全球半導體產能將達每月3,000萬片新高

New Semiconductor Fabs Starting Operations



圖說:全球晶圓廠預測,2022年至2024年期間,新投入營運的晶圓廠數量。

SEMI: 2024年全球半導體產能將達每月3,000萬片新高 | SEMI

SEMI國際半導體產業協會公佈最新一季全球晶圓廠預測報告(World Fab Forecast, WFF)·全球半導體產能繼2023年以5.5%成長至每月2,960萬片晶圓(wpm, wafers per month)之後·預計2024年將增速成長6.4%·突破3,000萬片大關。

最新一季全球晶圓廠預測報告顯示,2022年至2024年預測期間,全球半導體產業計劃將有82座新設施投產,其中2023年及2024分別有11座及42座投產,涵蓋了4吋(100mm)到12吋(300mm)晶圓的生產線。

中國晶片製造商預計2024年將展開18座新晶圓廠 · 產能年增率將從2023年的12%提升至2024年的13% · 產能將從760萬片推升成長至860萬片。

台灣·半導體產能年增率分別為2023年的5.6%及2024年的4.2%·每月產能由540萬片成長至570萬片·預計自2024年起將有5座新晶圓廠投產。

韓國·預計2024年將有1座新晶圓廠投產·產能將從2023年490萬片成長5.4%至2024年510萬片

日本·預計2024年將有4座新晶圓廠投產·產能將從2023年460萬片成長至2024年470萬片·年成長率約2%。

全球晶圓廠預測報告顯示,美洲地區到2024年將有6座新晶圓廠投產,晶圓產能年增率將達6%提升至310萬片。歐洲和中東地區在2024年將有4座新晶圓廠投產,預計將增加3.6%產能,達到270萬片。東南亞2024年將展開4座新晶圓廠投產,預計產能將增加4%,來到170萬片。



Q&A

